

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代號: 01347)

新聞稿

二零二五年第三季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2025 年 11 月 6 日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：01347；上交所科創板證券代碼：688347）（“本公司”）於今日公佈截至二零二五年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零二五年第三季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入創歷史新高，達 6.352 億美元，同比增長 20.7%，環比增長 12.2%。
- 毛利率 13.5%，同比上升 1.3 個百分點，環比上升 2.6 個百分點。
- 母公司擁有人應占利潤 2,570 萬美元，同比下降 42.6%，環比上升 223.5%。

二零二五年第四季度指引

- 我們預計銷售收入約在 6.5 億美元至 6.6 億美元之間。
- 我們預計毛利率約在 12%至 14%之間。

總裁致辭

公司董事會主席兼總裁白鵬博士對二零二五年第三季度業績評論道：

“華虹半導體二零二五年第三季度銷售收入創歷史新高，達 6.352 億美元，符合指引預期；毛利率為 13.5%，優於指引。在全球半導體需求回暖和公司精益管理的雙重驅動下，公司產能利用率持續高位運行，銷售收入和毛利率均實現同比及環比增長。公司在工藝研發、市場銷售、生產運營等核心競爭力的提升和降本增效的成果已逐步展現，整體盈利能力向好，為長期可持續發展奠定堅實基礎。”

白總繼續表示：“華虹半導體在特色工藝領域擁有豐富的積累儲備和優秀的管理經驗。面對快速變化的國內外半導體市場格局，公司需要在技術節點、工藝能力、產能建設等諸多核心維度不斷邁進。正在順利推進過程中的收購事項將進一步提升公司產能規模並豐富工藝平臺覆蓋，同時與無錫 12 英寸生產線形成協同效應，強化公司的盈利能力。此外，公司也在積極布局產能建設規劃，聚焦技術突破和生態構建，在全球產業變局中持續提升核心競爭力。”

電話會議公告

日期 2025 年 11 月 6 日，星期四

時間： 17:00 香港/上海時間

04:00 美國東部時間

發言人： 白鵬，董事會主席兼總裁
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 會議將在 https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php 或
<https://edge.media-server.com/mmc/p/e4idyvb2> 作線上直播
(請提前註冊登記)

電話直撥： 請在會議前使用以下鏈接先進行註冊。註冊後，您將收到確認郵件獲得撥入號碼及 PIN
(個人身份識別碼)。

<https://register-conf.media-server.com/register/BI0669e89919e0410ebaab072b3eb6b049>

重要提示：在會議開始前，您需要使用確認郵件中提供的 PIN (個人身份識別碼) 才能進入會議。請在註冊後，注意查收並保存確認郵件。出於安全原因，請不要與任何人共享您的 PIN (個人身份識別碼)。

網上重播： 直播約 2 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。
https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司 (A 股簡稱: 華虹公司, 688347; 港股簡稱: 華虹半導體, 01347) (“本公司”) 是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業, 秉持“8 英寸 + 12 英寸”、先進“特色 IC + Power Discrete”的發展戰略, 為客戶提供多元化的晶圓代工及配套服務。本公司專注於嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯與射頻等特色工藝技術的持續創新, 有力支持新能源汽車、綠色能源、物聯網等新興領域應用, 其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員, 而華虹集團是中國擁有“8 英寸 + 12 英寸”先進集成電路製造主流工藝技術的產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠, 另在無錫高新技術產業開發區內建有兩座全球領先的 12 英寸特色工藝晶圓廠, 其中之一是全球第一條 12 英寸功率器件代工生產線。

如欲取得更多公司相關資料, 請瀏覽: www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以仟美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二五年 第三季度 (未經審核)	二零二四年 第三季度 (未經審核)	二零二五年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	635,180	526,306	566,065	20.7 %	12.2 %
毛利	85,854	64,007	61,611	34.1 %	39.3 %
毛利率	13.5 %	12.2 %	10.9 %	1.3	2.6
經營開支	(100,433)	(81,430)	(97,917)	23.3 %	2.6 %
其他收入淨額	17,752	51,797	10,602	(65.7)%	67.4 %
稅前溢利/(損失)	3,173	34,374	(25,704)	(90.8)%	(112.3)%
所得稅開支	(10,363)	(11,461)	(7,097)	(9.6)%	46.0 %
期內(損失)/溢利	(7,190)	22,913	(32,801)	(131.4)%	(78.1)%
淨利潤率	(1.1)%	4.4 %	(5.8)%	(5.5)	4.7
以下各方應佔：					
母公司擁有人	25,725	44,816	7,952	(42.6)%	223.5 %
非控股權益	(32,915)	(21,903)	(40,753)	50.3 %	(19.2)%
持有人應佔每股盈利					
基本	0.015	0.026	0.005	(42.3)%	200.0 %
攤薄	0.015	0.026	0.005	(42.3)%	200.0 %
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	1,400	1,200	1,305	16.7 %	7.3 %
產能利用率 ¹	109.5 %	105.3 %	108.3 %	4.2	1.2
淨資產收益率 ²	1.6 %	2.8 %	0.4 %	(1.2)	1.2

二零二五年第三季度

- 銷售收入創歷史新高，達 6.352 億美元，同比增長 20.7%，環比增長 12.2%，主要得益於付運晶圓數量上升及平均銷售價格上漲。
- 毛利率 13.5%，同比上升 1.3 個百分點，主要得益於產能利用率及平均銷售價格提升，部分被折舊成本上升所抵消；環比上升 2.6 個百分點，主要得益於平均銷售價格上漲。
- 經營開支 1.004 億美元，同比上升 23.3%，主要由於研發工程片開支及折舊開支上升；環比上升 2.6%。
- 其他收入淨額 1,780 萬美元，同比下降 65.7%，主要由於外幣匯兌收益及利息收入下降，部分被財務費用下降所抵消；環比上升 67.4%，主要由於本季度為外幣匯兌收益，上季度為外幣匯兌損失。
- 所得稅開支 1,040 萬美元，同比下降 9.6%，主要由於應課稅利潤下降。
- 期內損失 720 萬美元，上年同期為溢利 2,290 萬美元，上季度為損失 3,280 萬美元。
- 母公司擁有人應佔利潤 2,570 萬美元，同比下降 42.6%，環比上升 223.5%。
- 基本每股盈利 0.015 美元，同比下降 42.3%，環比上升 200.0%。
- 淨資產收益率（年化）1.6%，同比下降 1.2 個百分點，環比上升 1.2 個百分點。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二五年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二五年 第三季度 % (未經審核)	二零二四年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	610,810	96.2 %	497,847	94.6 %	112,963	22.7 %
其他	24,370	3.8 %	28,459	5.4 %	(4,089)	(14.4)%
銷售收入總額	635,180	100.0 %	526,306	100.0 %	108,874	20.7 %

■ 本季度 96.2%的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二五年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二五年 第三季度 % (未經審核)	二零二四年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	258,805	40.7 %	263,139	50.0 %	(4,334)	(1.6)%
12 吋晶圓	376,375	59.3 %	263,167	50.0 %	113,208	43.0 %
銷售收入總額	635,180	100.0 %	526,306	100.0 %	108,874	20.7 %

■ 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 2.588 億美元及 3.764 億美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二五年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二五年 第三季度 % (未經審核)	二零二四年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 ³	522,621	82.3 %	434,532	82.5 %	88,089	20.3 %
北美 ⁴	63,832	10.0 %	46,709	8.9 %	17,123	36.7 %
亞洲其他 ⁵	30,302	4.8 %	28,707	5.5 %	1,595	5.6 %
歐洲	18,425	2.9 %	16,358	3.1 %	2,067	12.6 %
銷售收入總額	635,180	100.0 %	526,306	100.0 %	108,874	20.7 %

- 本季度來自於中國的銷售收入 5.226 億美元，占銷售收入總額的 82.3%，同比增長 20.3%，主要得益於閃存、其他電源管理及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於北美的銷售收入 6,380 萬美元，同比增長 36.7%，主要得益於其他電源管理及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲其他地區的銷售收入 3,030 萬美元，同比增長 5.6%。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 1,840 萬美元，同比增長 12.6%，主要得益於 IGBT 及智能卡芯片產品的需求增加。

³包括中國大陸及中國香港。

⁴包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

⁵包括中國台灣及日本。

銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二五年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二五年 第三季度 % (未經審核)	二零二四年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	159,658	25.1 %	132,598	25.2 %	27,060	20.4 %
獨立式非易失性存儲器	60,598	9.5 %	29,334	5.6 %	31,264	106.6 %
功率器件	169,036	26.7 %	163,253	31.1 %	5,783	3.5 %
邏輯及射頻	81,127	12.8 %	77,010	14.6 %	4,117	5.3 %
模擬與電源管理	164,761	25.9 %	124,111	23.5 %	40,650	32.8 %
銷售收入總額	635,180	100.0 %	526,306	100.0 %	108,874	20.7 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 1.597 億美元，同比增長 20.4%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度獨立式非易失性存儲器銷售收入 6,060 萬美元，同比增長 106.6%，主要得益於閃存產品的需求增加。
- 本季度功率器件銷售收入 1.690 億美元，同比增長 3.5%，主要得益於超級結產品需求增加。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 8,110 萬美元，同比增長 5.3%，主要得益於邏輯產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 1.648 億美元，同比增長 32.8%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二五年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二五年 第三季度 % (未經審核)	二零二四年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
65nm 及以下	172,197	27.1 %	116,596	22.2 %	55,601	47.7 %
90nm 及 95nm	144,396	22.7 %	98,966	18.8 %	45,430	45.9 %
0.11μm 及 0.13μm	73,231	11.5 %	68,274	13.0 %	4,957	7.3 %
0.15μm 及 0.18μm	36,492	5.7 %	37,894	7.2 %	(1,402)	(3.7)%
0.25μm	3,163	0.5 %	4,155	0.8 %	(992)	(23.9)%
0.35μm 及以上	205,701	32.5 %	200,421	38.0 %	5,280	2.6 %
銷售收入總額	635,180	100.0 %	526,306	100.0 %	108,874	20.7 %

- 本季度 65nm 及以下工藝技術節點的銷售收入 1.722 億美元，同比增長 47.7%，主要得益於閃存、邏輯及模擬產品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 1.444 億美元，同比增長 45.9%，主要得益於其他電源管理及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.11μm 及 0.13μm 工藝技術節點的銷售收入 7,320 萬美元，同比增長 7.3%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.15μm 及 0.18μm 工藝技術節點的銷售收入 3,650 萬美元，同比下降 3.7%。
- 本季度 0.25μm 工藝技術節點的銷售收入 320 萬美元，同比下降 23.9%，主要由於功率器件產品的需求下降。
- 本季度 0.35μm 及以上工藝技術節點的銷售收入 2.057 億美元，同比增長 2.6%，主要得益於超級結產品的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的 銷售收入	二零二五年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二五年 第三季度 % (未經審核)	二零二四年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
消費電子	407,544	64.1 %	330,928	62.9 %	76,616	23.2 %
工業及汽車	137,858	21.7 %	123,853	23.5 %	14,005	11.3 %
通信	79,843	12.6 %	65,952	12.5 %	13,891	21.1 %
計算	9,935	1.6 %	5,573	1.1 %	4,362	78.3 %
銷售收入總額	635,180	100.0 %	526,306	100.0 %	108,874	20.7 %

- 本季度消費電子作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 4.075 億美元，占銷售收入總額的 64.1%，同比增長 23.2%，主要得益於閃存、其他電源管理及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 1.379 億美元，同比增長 11.3%，主要得益於 MCU 及其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度通信類產品銷售收入 7,980 萬美元，同比增長 21.1%，主要得益於模擬及 RF 產品的需求增加。
- 本季度計算類產品銷售收入 990 萬美元，同比增長 78.3%，主要由於通用 MOSFET 及 MCU 產品的需求增加。

產能⁶及產能利用率

	二零二五年 第三季度 (未經審核)	二零二四年 第三季度 (未經審核)	二零二五年 第二季度 (未經審核)
總產能(折合 8 吋片晶圓)	468	391	447
總體產能利用率	109.5%	105.3%	108.3%

- 本季度末月產能 468,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 109.5%，較上季度上升 1.2 個百分點。

付運晶圓

折合 8 吋片晶圓	二零二五年 第三季度 (未經審核)	二零二四年 第三季度 (未經審核)	二零二五年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	1,400	1,200	1,305	16.7 %	7.3 %

- 本季度付運晶圓 1,400,000 片，同比上升 16.7%，環比上升 7.3%。

⁶ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

經營開支分析

以仟美元計	二零二五年 第三季度 (未經審核)	二零二四年 第三季度 (未經審核)	二零二五年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,332	2,241	2,630	4.1 %	(11.3)%
管理費用 ⁷	98,101	79,189	95,287	23.9 %	3.0 %
經營開支	100,433	81,430	97,917	23.3 %	2.6 %

- 經營開支 1.004 億美元，同比上升 23.3%，主要由於研發工程片開支及折舊開支上升；環比上升 2.6%。

其他收入淨額

以仟美元計	二零二五年 第三季度 (未經審核)	二零二四年 第三季度 (未經審核)	二零二五年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,625	3,612	3,460	0.4 %	4.8 %
利息收入	13,762	26,710	15,294	(48.5)%	(10.0)%
匯兌收入/(損失)	3,746	29,270	(1,064)	(87.2)%	(452.1)%
分佔聯營公司溢利	1,843	1,087	591	69.5 %	211.8 %
財務費用	(18,249)	(27,275)	(18,250)	(33.1)%	(0.0)%
政府補貼	12,741	18,535	9,866	(31.3)%	29.1 %
其他	284	(142)	705	(300.0)%	(59.7)%
其他收入淨額	17,752	51,797	10,602	(65.7)%	67.4 %

- 其他收入淨額 1,780 萬美元，同比下降 65.7%，主要由於外幣匯兌收益及利息收入下降，部分被財務費用下降所抵消；環比上升 67.4%，主要由於本季度為外幣匯兌收益，上季度為外幣匯兌損失。

⁷管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以仟美元計	二零二五年 第三季度 (未經審核)	二零二四年 第三季度 (未經審核)	二零二五年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得/(用)現金流量淨額	184,150	(26,838)	169,630	(786.2)%	8.6 %
投資活動所用現金流量淨額	(253,296)	(715,920)	(385,556)	(64.6)%	(34.3)%
融資活動所得/(用)現金流量淨額	104,163	(5,007)	(25,185)	(2,180.3)%	(513.6)%
外匯匯率變動影響淨額	22,816	90,648	8,076	(74.8)%	182.5 %
現金及現金等價物變動影響淨額	57,833	(657,117)	(233,035)	(108.8)%	(124.8)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 1.842 億美元，較上年同期經營活動所用現金流量 2,680 萬美元，主要得益於客戶收款增加。
- 投資活動所用現金流量淨額 2.533 億美元，其中包括固定資產投資支出 2.619 億美元，及其他權益工具投資 1,400 萬美元，部分被利息收入 1,560 萬美元，及收到政府對設備的補助 700 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 1.042 億美元，其中提取銀行借款 9,990 萬美元，員工行權發行股份收到 1,440 萬美元，部分被支付利息 500 萬美元，償還銀行借款 320 萬美元及支付租賃負債 190 萬美元所抵消。

資本結構

以仟美元計	於九月三十日 二零二五年 (未經審核)	於六月三十日 二零二五年 (未經審核)
資產總額	12,511,666	12,237,080
負債總額	3,502,618	3,363,437
所有者權益總額	9,009,048	8,873,643
資產負債率 ⁸	28.0%	27.5%

資本開支

以仟美元計	二零二五年 第三季度 (未經審核)	二零二五年 第二季度 (未經審核)
華虹 8 吋	19,305	17,612
華虹無錫	11,898	13,676
華虹製造	230,691	376,440
合計	261,894	407,728

- 本季度資本開支 2.619 億美元，其中 2.307 億美元用於華虹製造，1,930 萬美元用於華虹 8 吋，及 1,190 萬美元用於華虹無錫。

⁸資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以仟美元計	於九月三十日 二零二五年 (未經審核)	於六月三十日 二零二五年 (未經審核)
發展中物業	223,302	221,661
存貨	526,840	513,434
貿易應收款項及應收票據	257,067	264,329
預付款項、其他應收款項及其他資產	494,222	452,513
應收關聯方款項	22,150	14,360
已凍結存款及定期存款	31,993	31,756
現金及現金等價物	3,904,733	3,846,900
流動資產總額	5,460,307	5,344,953
貿易應付款項	275,064	263,352
其他應付款項及暫估費用	704,754	716,648
計息銀行借款	340,686	341,313
租賃負債	3,598	5,839
政府補助	66,498	59,040
應付關聯方款項	7,832	8,560
應付所得稅	14,341	16,046
流動負債總額	1,412,773	1,410,798
淨營運資金	4,047,534	3,934,155
速動比率	3.3x	3.3x
流動比率	3.9x	3.8x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	37	44
存貨周轉天數	85	88

- 存貨由上季度末的 5.134 億美元上升至本季度末的 5.268 億美元，主要由於新工廠的在製品及產成品增加。
- 預付款項、其他應收款項及其他資產由上季度末的 4.525 億美元上升至本季度末的 4.942 億美元，主要由於增值稅留抵稅額增加。
- 貿易應付款項由上季度末的 2.634 億美元上升至本季度末的 2.751 億美元，主要由於採購額增加。
- 其他應付款項及暫估費用由上季度末的 7.166 億美元下降至本季度末的 7.048 億美元，主要由於本季度支付應付資本開支。
- 淨營運資金 本季度末 40.475 億美元，流動比率 3.9。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數 37 天。
- 存貨周轉天數 85 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以仟美元計,每股盈利和股数除外)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日 二零二五年 (未經審核)	於九月三十日 二零二四年 (未經審核)	於六月三十日 二零二五年 (未經審核)
銷售收入	635,180	526,306	566,065
銷售成本	(549,326)	(462,299)	(504,454)
毛利	85,854	64,007	61,611
其他收入及收益	34,361	78,092	29,353
銷售及分銷費用	(2,332)	(2,241)	(2,630)
管理費用	(98,101)	(79,189)	(95,287)
其他費用	(203)	(107)	(1,092)
財務費用	(18,249)	(27,275)	(18,250)
分佔聯營公司溢利	1,843	1,087	591
稅前溢利/(損失)	3,173	34,374	(25,704)
所得稅開支	(10,363)	(11,461)	(7,097)
期內(損失)/溢利	(7,190)	22,913	(32,801)
以下各方應佔：			
母公司擁有人	25,725	44,816	7,952
非控股權益	(32,915)	(21,903)	(40,753)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.015	0.026	0.005
攤薄	0.015	0.026	0.005
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,731,461,953	1,717,612,830	1,726,241,791
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,733,014,365	1,721,402,553	1,731,895,843

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以仟美元計)

	截至		
	於九月三十日 二零二五年 (未經審核)	於六月三十日 二零二五年 (未經審核)	於九月三十日 二零二四年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	6,162,217	6,101,971	5,198,989
投資物業	220,223	218,468	168,433
使用權資產	65,141	66,002	81,372
無形資產	33,982	27,313	38,897
於聯營公司的投資	147,349	144,421	144,534
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	381,305	290,515	290,857
長期預付款項	41,142	42,672	83,396
遞延稅項資產	-	765	795
非流動資產總額	7,051,359	6,892,127	6,007,273
流動資產			
發展中物業	223,302	221,661	225,711
存貨	526,840	513,434	487,480
貿易應收款項及應收票據	257,067	264,329	268,186
預付款項、其他應收款項及其他資產	494,222	452,513	269,191
應收關聯方款項	22,150	14,360	25,426
已凍結存款及定期存款	31,993	31,756	32,443
現金及現金等價物	3,904,733	3,846,900	5,766,749
流動資產總額	5,460,307	5,344,953	7,075,186
流動負債			
貿易應付款項	275,064	263,352	273,352
其他應付款項及暫估費用	704,754	716,648	1,237,992
計息銀行借款	340,686	341,313	262,296
租賃負債	3,598	5,839	4,451
政府補助	66,498	59,040	40,072
應付關聯方款項	7,832	8,560	10,167
應付所得稅	14,341	16,046	26,494
流動負債總額	1,412,773	1,410,798	1,854,824
流動資產淨額	4,047,534	3,934,155	5,220,362
總資產減流動負債	11,098,893	10,826,282	11,227,635
非流動負債			
計息銀行借款	2,056,802	1,933,971	1,983,494
租賃負債	15,329	15,035	19,334
遞延稅項負債	17,714	3,633	9,388
非流動負債總額	2,089,845	1,952,639	2,012,216
淨資產	9,009,048	8,873,643	9,215,419
權益和負債權益			
股本	4,982,556	4,960,855	4,936,472
儲備	1,466,529	1,339,047	1,478,303
本公司擁有人應佔權益	6,449,085	6,299,902	6,414,775
非控股權益	2,559,963	2,573,741	2,800,644
權益總額	9,009,048	8,873,643	9,215,419

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以仟美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日	於九月三十日	於六月三十日
	二零二五年 (未經審核)	二零二四年 (未經審核)	二零二五年 (未經審核)
經營活動現金流量：			
稅前溢利/(虧損)	3,173	34,374	(25,704)
折舊及攤銷	187,269	143,557	179,658
應佔聯營公司溢利	(1,843)	(1,087)	(591)
營運資金的變動及其它	(4,449)	(203,682)	16,267
經營活動所得/(用)現金流量淨額	184,150	(26,838)	169,630
投資活動現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(261,894)	(734,069)	(407,728)
投資其他權益工具	(14,030)	-	-
投資聯營企業	-	-	(2,794)
其他投資活動所得現金流量	22,628	18,149	24,966
投資活動所用現金流量淨額	(253,296)	(715,920)	(385,556)
融資活動現金流量：			
提取銀行貸款	99,923	2,287	138,096
發行股份所得收益	14,376	1,471	2,218
償還銀行貸款	(3,284)	(4,476)	(125,677)
已付利息	(4,971)	(3,283)	(38,623)
支付租賃負債	(1,881)	(1,004)	(1,199)
支付股息	-	(2)	-
融資活動所得/(用)現金流量淨額	104,163	(5,007)	(25,185)
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	35,017	(747,765)	(241,111)
期初現金及現金等價物	3,846,900	6,423,866	4,079,935
外匯匯率變動影響淨額	22,816	90,648	8,076
期末現金及現金等價物	3,904,733	5,766,749	3,846,900

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

白鵬(董事長兼總裁)

非執行董事

葉峻

孫國棟

陳博

熊承艷

獨立非執行董事

張祖同

王桂壩太平紳士

封松林

承董事会命

華虹半導體有限公司

白鵬

董事長兼執行董事

中國 香港

二零二五年十一月六日